



6F03【秋田】半導体デバイス製造関連装置制御エンジニア（フリップチップボンダー）

TDK株式会社での募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある方は歓...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

TDK株式会社

Job ID

1511709

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Akita Prefecture

Salary

6 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】初年度 21日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始

Refreshed

December 19th, 2024 17:21

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2212595】

半導体デバイス製造関連装置（主にフリップチップボンダー）及びカスタム製品の開発部署において、装置の回路設計と動作プログラミングを主とした下記の業務を担当いただきます。

- ・制御回路設計
- ・動作プログラミング（シーケンサ使用）
- ・画像処理プログラミング（市販画像処理コントローラ使用）

Required Skills

■必須条件：

下記いずれかに該当される方

- ・2級電気機器組立て技能士相当の電気知識・経験
 - ・2級機械保全（シーケンス制御作業）技能士相当のプログラミング知識・経験
-

Company Description

■受動部品・セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品・温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品・マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品・エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他・フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器